Para realizar el stackup hemos decidido utilizar 2 planos de masa y alimentación adyacentes (para así aprovechar el efecto capacitivo) y 2 planos externos de masa para apantallar las señales. Entre un plano externo y el centro-condensador se encontrarán los buses y las señales de alta frecuencia, mientras que tras el otro plano eterno se implementarán las señales de baja frecuencia y las analógicas.

Debido al elevado número de GPIOs, la capa de apantallamiento de señales de baja frecuencia también se podrá rutar.

